SBS TOSHIBA LOGISTICS News



2025年11月27日

各 位

SBS東芝ロジスティクス株式会社

「3DEXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」でDX事例を発表

-段ボール包装の落下衝撃解析で"物流を、超えていけ"ー

SBS東芝ロジスティクス株式会社(社長:金澤 寧、本社:東京都新宿区)は11月14日、ダッソー・システムズ株式会社が主催する「3DEXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」(於:虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区)) において、当社の包装設計における構造解析活用のDX事例を発表したことをお知らせします。

♦

「3DEXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」は SOLIDWORKS ブランドによる国内最大級の 3 次元 CAD イベントで、「One Step Beyond ~踏み出そう、つながる未来へ~」をテーマに、設計・製造・改善がつながり、価値を繰り返し生み出すものづくりや、アイデアが波紋のように広がり、一つの行動が次の創造を生み、変化を連鎖させていく、"SOLIDWORKS でつながる未来、設計のチカラ"を体感できる場として開催されました。

同イベントのユーザー事例講演に、当社の包装・治具技術担当の戸田太地(とだ たいち) が登壇し、『段ボール包装の落下衝撃解析 ~物流を、超えていく~』と題した DX 事例を発表して 100 名超に聴講いただきました。

本講演では、昨今の環境対応・脱プラスチックでエコな包装材として注目されている段ボールについて、当社の包装設計における構造解析の活用事例を発表しました。市販 CAE では段ボールの材料特性データ(素材強度値)が十分に揃っていない中、自社所有の試験設備で段ボールの材料試験を行うことにより、CAE 利用できる材料特性データを作成し、製品を保護する包装材として段ボール落下衝撃解析へ挑戦することで、お客様への付加価値ソリューションにつなげました。





ユーザー事例講演の様子(写真:戸田 太地(包装・治具技術担当))

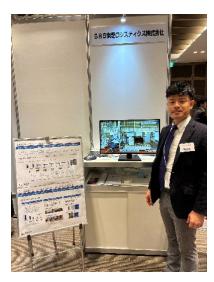


SBS TOSHIBA LOGISTICS News



また、同日に講演企業としてブース出展し、当社の強みである包装技術ソリューションとして、DFL (デザイン・フォー・ロジスティクス) 包装設計、IS017025 認定包装試験、包装貨物衝撃シミュレーションの各種サービスを紹介して多くの方にお越しいただきました。





ブース出展の様子(写真: 左から内田 幸義(包装・治具技術担当 グループ長)、戸田 太地(包装・治具技術担当))

当社は、今後もお客様へ最適なサービスを提供すべく、デジタル技術を最大限に活用しなが ら、包装・治具設計を通じてお客様の品質向上、環境負荷低減、コスト低減、作業性向上を図っ て参ります。

以上



SBS TOSHIBA LOGISTICS News



■ご参考

<ダッソー・システムズ株式会社 SOLIDWORKS 顧客事例>

URL: https://www.solidworks.com/ja/story/sbs_toshiba_logistics

< SBS東芝ロジスティクス株式会社 概要>

本社住所:東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25 階

代表者:代表取締役社長 金澤 寧

設 立:1974年10月1日

親 会 社: SBSホールディングス株式会社(持株比率 66.6%)

資本金:21億28百万円

売 上 高:1,153 億円(2024 年 12 月期、連結) 従業員数:2,780 名(2024 年 12 月末現在、連結)

関連会社:国内にSBSロジスター(株)、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に14社

事業内容:倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業

航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他

U R L: https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

SBS東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部

TEL: 03-6772-8201 (代表) /URL: https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/

※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

